希荻微电子集团股份有限公司

公司代码:688173 公司简称:希荻微

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节 管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为负,且充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定的2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用□不适用

截至报告期末,公司母公司报表中期末未分配利润为-15,498.47万元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司不满足实施现金分红的前提条件。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	希荻微	688173	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢海航	周紫慧
联系地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元(住所申报)	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元(住所申报)
电话	0757-81280550	0757-81280550
传真	0757-86305776	0757-86305776
电子信箱	ir@halomicro.com	ir@halomicro.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一,主营业务为包括电源管理芯片和信号链芯片在内集成电路的研发、设计和销售。公司主要产品为服务于消费类电子和车载电子领域的集成电路,现有产品布局覆盖DC/DC芯片、锂电池充电管理芯片、高集成度PMIC芯片、端口保护和信号切换芯片、电源转换芯片、音圈马达驱动芯片以及传感器芯片等,具备高效率、高精度、高可靠性等良好性能。截至2025年末,公司主要产品布局如下图所示:

(1)高性能 DC/DC 及 PMIC 芯片

公司DC/DC及PMIC芯片产品线包括降压转换DC/DC芯片、升压转换DC/DC芯片、LDO稳压器芯片以及高集成度PMIC等系列产品,可以应用于消费电子、汽车电子以及计算与存储等领域,实现业内领先的低功耗特性、卓越的负载瞬态响应能力、高效转换效率及高稳定性能。

在消费电子领域,公司多款消费级DC/DC芯片较早进入了Qualcomm平台参考设计,各类产品可以为智能手机、可穿戴等移动终端智能电子设备AP、GPU、LPDDR、WiFi模组、摄像头模组、OTG功能、屏幕、硅负极电池等核心单元供电,已广泛应用于三星、小米、vivo、OPPO、联想等品牌客户的消费电子设备中,覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动终端智能电子设备。2025年,公司推出了多款高效低功耗DC/DC降压转换芯片以满足客户需求。

在汽车电子领域,公司车规级芯片达到了AEC-Q100标准,其中DC/DC芯片进入了Qualcomm智能座舱汽车平台参考设计,已实现了向Joynext、Yura Tech等全球知名的汽车前装厂商出货,并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等中欧日韩多个品牌汽车中。此外,公司高压LDO稳压器芯片和高边开关芯片已实现了向国内多家头部客户批量出货,高低边开关芯片的种类不断丰富。报告期内,公司亦推出了车规级PMIC芯片产品,可以为摄像头模组内MCU、SerDes和图像传感器等提供紧凑、低噪声、高效率的电源管理解决方案。

在计算与存储领域,公司10-20A的POL芯片产品已经在与下游多家客户进行软硬件适配,部分客户将进入量产爬坡阶段。针对20-50A电流范围,公司已有对应的POL芯片和功率模组样品,目前正在与目标客户进行初步联调。未来,公司将推出更大电流和更高集成度电源解决方案,以满足数据中心、AI算力等领域的更高功率需求。

(2)锂电池充电管理芯片

公司锂电池充电管理芯片产品线主要围绕快充芯片和超级快充芯片进行产品布局,细分品类包括线性充电芯片、开关充电芯片、电荷泵充电芯片等系列产品,主要应用于消费电子领域,可以助力移动终端智能电子设备实现高效、快速、安全充电。

中信证券研报显示,凭借充电功率高、系统成本低、兼容性强等优势,电荷泵已成为手机快充的主流方案。公司自主研发的双相充电拓扑结构在大电流充电的情况下实现极小的电压纹波,电荷泵充电管理芯片产品覆盖2:1、4:1和4:2等多种架构,可以支持2C-4C电池快速充电功能,在充电效率、充电功率等方面具有相较海外厂商竞品更良好的表现,且具备更好的电路保护功能和更小的芯片面积。

此外,公司通过围绕市场需求不断推陈出新,帮助客户进一步提升使用体验。报告期内,公司锂电池充电管理芯片已成功导入三星、传音、荣耀、影石等全球知名品牌客户的供应链体系,位列国产电荷泵充电芯片第一梯队供应商。

(3)端口保护及信号切换芯片

公司端口保护及信号切换芯片产品线包括音频和数据开关芯片、SIM卡电平转换芯片、OVP负载开关、USB Type-C端口保护芯片以及GPIO拓展器芯片等系列产品,集成了高压负载开关、输出过压保护、输入欠压保护、过温保护、短路/过流/反向电流保护等功能,赋能移动终端智能电子设备接口转换与安全,广泛应用于以智能手机、笔记本电脑为代表的消费电子领域。

此外,公司推出的E-Fuses负载开关芯片系列产品亦可提供全面的保护功能,包括过载保护、过压保护、过温保护和反向电流阻断等,为消费电子、计算与存储等领域提供高可靠供电保障。

(4)音圈马达驱动芯片

公司音圈马达驱动芯片产品线(即智能视觉感知业务),包括开环式自动对焦芯片(如传统音圈电机驱动芯片和双向音圈电机驱动芯片)、闭环式自动对焦芯片以及光学防抖芯片(如eOIS芯片、SMA OIS芯片以及Fold-ed&C-Zoom OIS芯片)等系列产品。音圈马达驱动芯片可以精确控制音圈马达的运动,驱动摄像头模组内的镜头完成对焦、防抖等系列机械动作,从而保障图像或视频的清晰度与稳定性。

公司于2022年12月与全球知名芯片厂商韩国初运达成合作,获得其自动对焦(AF)及光学防抖(OIS)技术在大中华地区的独占使用权。自2023年第三季度起,公司以自有品牌全面布局智能视觉感知业务。截至2025年末,公司已围绕该产品线搭建了供应链,推动该业务从贸易模式向自产模式转换。同时,公司还组建了专项研发团队,以市场需求为牵引布局下一代产品,通过技术迭代实现产品线在丰富度与性能上的阶梯式升级。

公司与绍宇、欧菲光、丘钛微、立景创新等知名模组厂商建立合作,相关产品已进入vivo、荣耀、传音、OPPO、小米、联想、科大讯飞、视源股份等品牌客户的供应链体系,广泛应用于智能手机、学习平板、掌上电脑、视频会议设备等各类移动终端设备。在智能手机摄像头核心部件领域,公司音圈马达驱动芯片凭借技术与规模优势,稳居细分市场头部供应商地位;同时正加速布局运动相机、无人机等新兴摄像头应用场景,持续拓展业务边界以巩固技术引领力与市场竞争力。

(5)传感器芯片及其他

公司于2024年8月完成对韩国芯片设计上市公司Zinitix(303030.KS)控股权的收购,其产品线包括触摸控制器芯片及模组(Touch Controller IC and Module)、触觉反馈驱动器(Haptic Driver IC)、磁性安全传输芯片(Magnetic Security Transmission IC)等。

Zinitix核心产品线为触摸控制器芯片(Touch Controller IC),它以传感技术为核心构建,能将触摸输入精准转换为电信号,并通过混合传感技术实现更精准的触摸识别,其搭载高速全通道/多驱动器架构,可与AMOLED、LCD等多种显示面板完美适配,从而满足各类终端电子设备的显示需求。截至2025年末,Zinitix相关产品已导入三星等国际知名品牌的供应链体系,广泛应用于智能手机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑等移动及可穿戴设备,成为提升人机交互体验的关键技术支撑。

2.2 主要经营模式

公司采用Fabless经营模式,专注于包括电源管理芯片和信号链芯片在内的模拟集成电路及数模混合集成电路的研发、设计和销售环节,将晶圆制造及封装测试环节委托给相应的代工厂完成。具体而言,公司在芯片产品的研发完成后,将研发成果即集成电路产品布图交付给专业的晶圆代工厂和封测厂,分别委托其进行晶圆制造和封装测试,再将芯片成品直接或通过经销商销售给下游客户。

在Fabless经营模式下,公司有效规避了大规模固定资产投资所带来的财务风险。这使得公司能够更专注于高价值创造的设计开发环节,从而显著提高运营效率,加速新技术和新产品的研发进程,进而提升整体竞争力。在销售环节,公司采用直销和代理经销相结合的销售模式,可有效降低新客户开发的成本,控制应收账款回款风险,并提高公司运作效率和市场响应速度。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业属于集成电路设计行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为"信息传输、软件和信息技术服务业"中的"软件和信息技术服务业"中的"集成电路设计",行业代码"16520"。近年来,AI(人工智能)、5G通信、物联网、自动驾驶等新兴技术的快速发展,促使集成电路产业不断进行技术创新和产业升级。

1.集成电路行业概况

集成电路(Integrated Circuit,IC)是一种微型电子器件或部件,其采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。

集成电路产业链主要由"设计——制造——封装测试"三个环节构成,集成电路产业是以技术作为核心驱动因素的产业,在设计环节上技术与资本高度密集,是带动整体产业发展的核心因素,也同样是经济附加值最高的环节。集成电路行业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产品根据功能主要可分为数字芯片和模拟芯片,其中数字芯片指基于数字逻辑设计和运行的,用于处理数字信号的集成电路芯片,包括微元件,存储器和逻辑芯片;模拟芯片指处理连续性模拟信号的集成电路芯片,包括电源管理芯片和模拟信号处理芯片。其中,电源管理芯片是电子设备中的关键器件,具有较高的技术和渠道壁垒,其性能表现将直接影响电子产品的性能和可靠性。

2.全球模拟芯片的发展情况

由于模拟芯片广泛应用于各种电子产品和系统中,包括消费电子、汽车、通信、计算和存储等,这种广泛、分散的应用为模拟芯片市场提供了多样化的需求来源。模拟芯片因其使用周期长的特性,市场规模呈现稳步扩张的态势。全球AI计算基础设施、智能汽车电子与通讯网络升级的范式变革,也推动了模拟芯片需求的增加。

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国模拟芯片行业市场调研及发展趋势预测报告》显示,2025年全球模拟芯片市场规模将超过1,000亿美元。世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布预测,2025年全球模拟芯片规模实现6.7%的修复性增长,规模达843.4亿美元。

3.中国模拟芯片行业的发展情况

集成电路是一个高度全球化的产业,中国集成电路产业虽起步较晚,但凭借巨大的市场需求,经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件,已成为全球集成电路行业增长的主要驱动力。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国模拟芯片行业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示,中国模拟芯片市场规模从2021年的1,570亿元增长至2024年的1,953亿元,年均复合增长率达7.5%,2025年市场规模约2,203亿元。中商产业研究院分析师预测,2026年中国模拟芯片市场规模将达到2,451亿元。

在政策扶持和中美贸易摩擦的大背景下,中国集成电路产品的品质和市场认可度日渐提升,部分本土企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起,整体技术水平和国外设计公司的差距不断缩小,国内企业设计开发的模拟芯片产品在多个应用市场领域逐渐取代国外竞争对手的份额。

据海关总署统计,2025年中国集成电路出口达2,019亿美元,同比增长26.8%,首次突破2,000亿美元大关并创下历史新高。国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》指出,集成电路产业的发展目标是到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。主要任务和发展重点是着力发展集成电路设计业,加速发展集成电路制造业,提升先进封装及测试业发展水平,突破集成电路关键装备和材料。

未来,随着消费电子、汽车电子、工业控制,计算与存储等领域的市场需求不断提升,以及国家支持政策的不断提出,芯片的国产化渗透率将进一步提升;而国内本土企业研发产业化加速落地、多元化产品方案日趋成熟,整个市场格局有望进入调整期,中国模拟芯片市场有望开启新一轮的增长。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

中信建投研究报告显示,由于模拟芯片产品种类繁多,生命周期长,下游应用高度碎片化,各领域对芯片的性能、功耗、成本要求差异显著,催生了针对特定需求的细分市场,任何单一企业难以全面覆盖。因此行业天然呈现"规模大但集中度低"的特征。全球CR 10长期维持在60%左右,国际领先企业TI的市占率最高也不足20%,难以出现垄断格局。

根据中国半导体行业协会集成电路设计分会数据,截至2025年末,我国有约3,901家集成电路设计企业,预计有831家企业2025年销售额超过1亿元,占比仅21.3%,86.5%的企业是人数少于100人的小微企业,共3,375家。集成电路设计企业数量众多,但大部分盈利能力较低。

公司是国内领先的电源管理及信号链芯片供应商之一,拥有具备国际化背景的行业高端研发及管理团队,开发出了一系列具有高效率、高精度、高可靠性等良好性能的芯片产品。2025年度,公司实现营业总收入93,943.50万元,较上年同期上升72.21%,截至2026年4月16日,营收增速在申万模拟芯片设计A股上市公司分类中排名第2。

在消费电子领域,公司多款产品得到了高通(Qualcomm)、联发科(MTK)等主芯片平台厂商的认可,已广泛应用于三星、vivo、传音、OPPO、小米、荣耀、谷歌、罗技、联想等品牌客户的消费电子设备中,覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动智能终端设备。

在汽车电子领域,公司车规级芯片达到了AEC-Q100标准,其中DC/DC芯片进入了Qualcomm智能座舱汽车平台参考设计,已实现了向Joynext、Yura Tech等全球知名的汽车前装厂商出货,并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等中欧日韩多个品牌汽车中。此外,公司高压LDO稳压器芯片和高边开关芯片已实现了向国内多家头部客户批量出货。

在计算与存储领域,公司10-20A的POL芯片产品已经在与下游多家客户进行软硬件适配,部分客户将进入量产爬坡阶段。针对20-50A电流范围,公司已有对应的POL芯片和功率模组样品,目前正在与目标客户进行初步联调。未来,公司将推出更大电流和更高集成度电源解决方案,以满足数据中心、AI算力等领域的更高功率需求。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

模拟芯片的应用领域非常广泛,中商产业研究院发布的《2025-2030年中国模拟芯片行业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示,模拟芯片在消费电子领域应用最广,占比36.97%;其次是泛能源和汽车领域,分别占比25.96%、19.00%。由于中国模拟芯片供应链发展相对较晚,市场供应仍然严重依赖国际供应商。2024年模拟芯片国产化率方面,消费电子领域为40-50%,通讯领域为20-25%,工业领域为10-15%,及汽车领域为5%左右。在国内政策的支持和供应链的共同努力下,本土企业不断攻克关键技术,产品组合日益丰富,在各个细分市场的渗透率不断提高,预计未来几年中国模拟芯片的自给率将快速提升。

模拟集成电路产业将会朝着高效低耗化、集成化以及智能化的趋势发展。目前,电源管理芯片最大的终端市场仍然是手机等消费类电子产品,但由于该市场竞争不断加剧,盈利空间被压缩;而另一方面,汽车电子、高性能计算、工业应用等下游需求不断增长,未来随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展,全球需要的电子设备数量及种类迅速增长,在汽车和工业电源芯片市场应用领域,由于其应用技术要求较高,相应的产品毛利率较高。整体来看,未来电源管理芯片应用领域从低端消费电子市场向高端工业、汽车市场转型将成为行业发展的新趋势。

随着多芯片集成、快速充电和先进电源效率管理的兴起,电源管理芯片的复杂性和规格也不断提升,其单位价值亦随之不断提升,推动了电源管理芯片市场的持续增长。而智能手机轻薄化发展趋势也要求高性能芯片产品进一步降低功耗和缩小器件体积。此外,深度受益于国产替代和光学升级,音圈马达驱动芯片已广泛应用于智能手机尤其是旗舰机型之中。

目前,全球半导体行业呈现结构性复苏态势,希荻微将借助积累的技术优势、客户基础,拓展产品丰富度,对现有产品进一步升级,横向拓展公司产品应用领域,提高公司整体竞争实力。具体体现为充实在电源管理、端口保护和信号切换、音圈马达驱动芯片、传感器芯片等细分领域的芯片产品布局,并有序拓展电源转换产品等领域。此外,公司将在现有消费电子应用领域的基础上,以满足AEC-Q100标准的产品为基础,积极布局汽车电子领域,发力计算与存储等领域,不断建立新的收入增长点。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,851,966,327.09	1,810,336,339.19	2.30	2,016,373,736.11
归属于上市公司股东的净资产	1,424,570,754.60	1,478,987,485.53	-3.68	1,834,938,568.16
营业收入	939,434,993.17	545,510,607.86	72.21	393,632,323.78
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	934,348,650.09	493,312,371.70	89.40	368,094,018.58
利润总额	-142,818,444.47	-298,673,685.09	不适用	-87,578,756.30
归属于上市公司股东的净利润	-113,918,566.81	-290,597,343.59	不适用	-54,184,639.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,719,680.60	-300,204,783.40	不适用	-187,281,894.01
经营活动产生的现金流量净额	-165,665,147.68	-218,484,467.40	不适用	-245,012,004.35
加权平均净资产收益率(%)	-7.88	-17.59	增加9.71个百分点	-2.97
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.74	不适用	-0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.74	不适用	-0.13
研发投入占营业收入的比例(%)	27.80	46.31	减少18.51个百分点	60.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	177,679,311.25	288,769,973.46	250,551,174.28	222,434,534.18
归属于上市公司股东的净利润	-27,264,802.83	-17,423,606.29	-31,666,325.09	-37,563,832.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,252,099.94	-18,265,163.89	-32,966,122.94	-39,236,293.83
经营活动产生的现金流量净额	-42,344,944.30	-24,227,437.03	-57,146,991.82	-41,945,774.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,570
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,676
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
戴祖渝	0	93,790,457	22.74	0	无	0	境内自然人
唐媛	0	58,864,836	14.28	0	无	0	境内自然人
重庆唯纯企业管理咨询有限公司	-8,031,191	29,846,925	7.24	0	无	0	境内非国有法人
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳辰芯创业投资合伙企业(有限合伙)	-8,766,799	11,748,655	2.85	0	无	0	其他
郝跃国	0	10,153,580	2.46	0	质押	10,150,000	境内自然人
范俊	-3,000,000	10,049,225	2.44	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,114,481	8,719,173	2.11	0	无	0	境外法人
佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	0	8,686,934	2.11	0	无	0	其他
叶芳丽	0	4,349,742	1.05	0	无	0	境内自然人
广东杭承贸易有限公司	0	4,312,703	1.05	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,戴祖渝和TAO HAI签订了表决权委托协议;戴祖渝、唐媛与TAO HAI签订了一致行动协议及补充协议,佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙)的合伙人为唐媛和TAO HAI。 因戴祖渝于2025年5月退世,其持有公司的股份全部由TAO HAI继承,TAO HAI与唐媛于2025年8月25日重新签署了《一致行动协议》,详见公司于2025年8月26日披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于实际控制人重新签署一致行动协议的公告》(公告编号:2025-066)。除此之外,公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

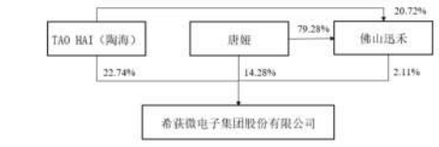
□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



注:截至报告日,TAO HAI(陶海)持有公司22.86%的股份仍登记在戴祖渝名下,TAO HAI(陶海)正在办理股票继承的过户手续。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入93,943.50万元,实现归属于母公司所有者的净利润-11,391.86万元。截至2025年12月31日,公司总资产为185,196.63万元,归属母公司所有者的净资产为142,457.08万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-045

希荻微电子集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月7日 09点00分

召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月7日

至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》	√
5	《关于(公司2025年年度报告)及其摘要的议案》	√
6	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》	√
9	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
10	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十三次会议审议通过。详见分别于2026年4月10日、2026年4月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:作为公司董事的股东以及与公司董事存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688173	希荻微	2026/4/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2026年4月29日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00);

登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

联系电话:0757-81280550

联系人:卢海航

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

希荻微电子集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》			
5	《关于(公司2025年年度报告)及其摘要的议案》			
6	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》			
9	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》			
10	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-043

希荻微电子集团股份有限公司
关于质押全资子公司股权向银行申请并购贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")拟质押全资子公司深圳市诚芯微科技有限公司(曾用名"深圳市诚芯微科技股份有限公司",以下简称"诚芯微")100%的股权为公司向银行申请不超过人民币2.48亿元的并购贷款提供担保。

一、情况概述

公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于现金收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份的议案》,同意公司以现金方式收购曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业(有限合伙)合计持有的诚芯微100%的股权(以下简称"本次交易")。本次交易价格参考评估值并经交易各方协商确定,最终确定为31,000.00万元。本次交易完成后,诚芯微将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于以现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份的公告》(公告编号:2026-003)。

公司于2026年1月23日召开第二届董事会第三十次会议,于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》,同意公司